techforum
beyond technology

주소: 서울시 금천구 가산디지털1로 196, 1206 | www.techforum.co.kr | contact@techforum.co.kr | Tel: 070-7169-5396 | Fax: 070-7159-1608

문서번호: 제20190926호
수 신:
참 조:
발 신: 테크포럼(주)
제 목: '2019 자동차 전장부품 차세대 열관리 기술 세미나' 안내

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 9월 26일(목) 오전 10시에 한국기술센터 16층 국제회의실에서 '2019 자동차 전장부품 차세대 열관리 기술 세미나' 를 개최합니다.

3. 본 세미나에 많은 관심과 참여 부탁 드립니다.

- 아 래 -

가. 행사명: 2019 자동차 전장부품 차세대 열관리 기술 세미나
나. 일시: 2019년 9월 26일(목) 10시~17시
다. 장소: 한국기술센터 16층 국제회의장
라. 주최/주관: (주)델타이에스, 테크포럼
마. 후원: Siemens Digital Industry Software Korea
바. 세부일정

시간	주제
10:00~10:50 [트랙1]	차세대 전장부품의 방열 이슈 대응을 위한 고기능성 점접착 기술개발 동향
11:00~11:50 [트랙2]	차세대 전장부품 열저항 측정 및 시뮬레이션을 이용한 최고속 방열 최적화 기술
12:00~12:50 [트랙3]	EV & 5G 분야의 Thermal Solution
14:00~14:50 [트랙4]	수소 전기차, 자율주행차 전장부품용 고방열/내열 소재/부품 이슈와 대응기술
15:00~15:50 [트랙5]	전자소자 및 전장부품 분야 고방열 소재/부품 기술 개발 동향 및 적용 사례
16:00~16:50 [트랙6]	극한의 전력밀도에서의 냉각 기술

※ 발표 주제 및 일정은 연사/주최측의 사정에 의해 공지 없이 변경될 수 있습니다.

사. 등록비
A. 사전결제: 253,000원(부가세/중식/자료집/PDF 포함) - 9월 25일(수) 18시까지
B. 현장결제: 286,000원(부가세/중식/자료집/PDF 포함)

테 크 포 럼 (주)